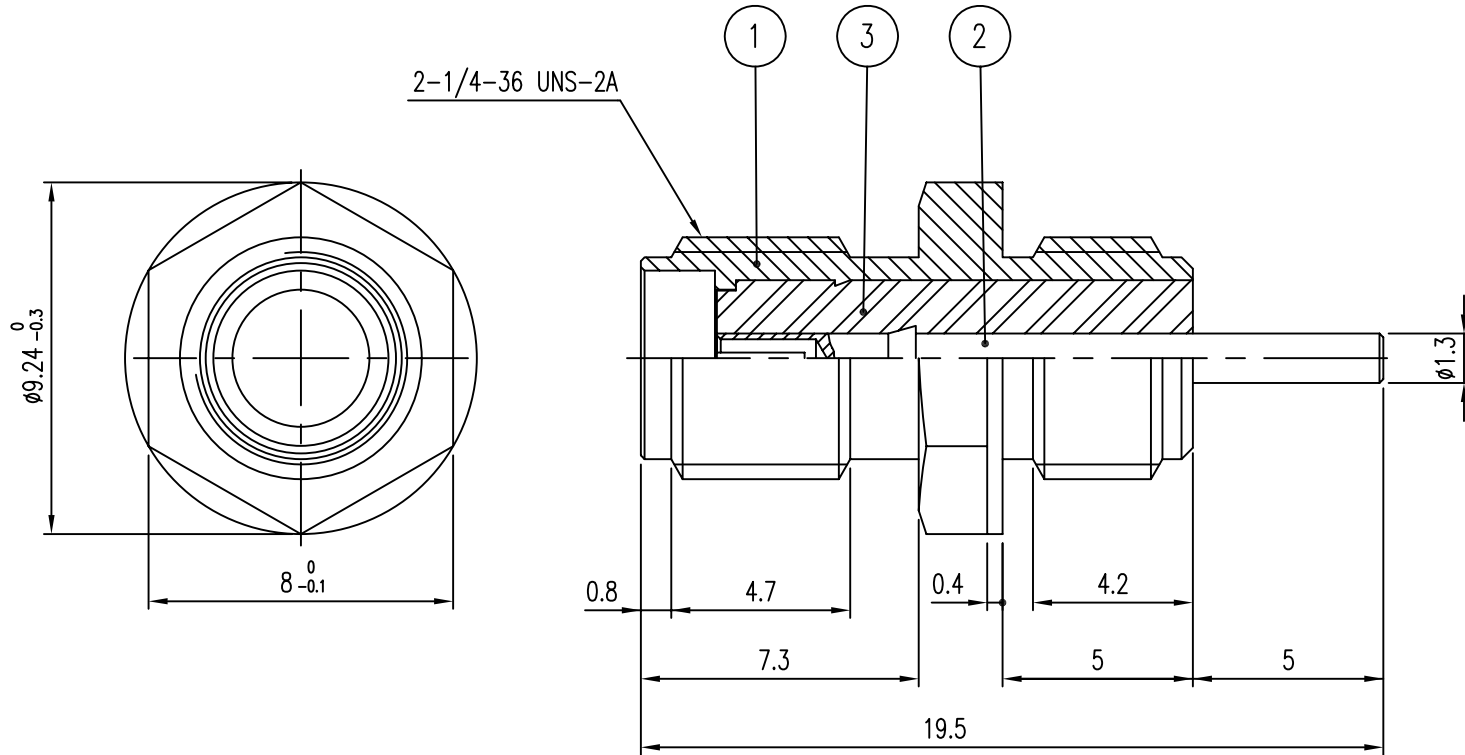


ST	가공											수 정 내 용				
												부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기초)												1	조립성 개선(C0.3-> C0.5)	김은희	안병호	2004. 1. 5.
ST(개선)												2	바다 공용화로 인한 부품 코드 변경	은선영	김인철	2019. 10. 07.



2 1	3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN02877-N/1 DIN02877-N/1 (H2237)
	2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00227-5/1 (E2351)
	2	1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate
대체가능재질	품번	품명	수량	재질	표면처리	비고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일	2002. 11. 12.		KJ COMTECH RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	승인					
재질	검도			도명 SJ-NUT		
열처리	제도					
보호피막처리	작성부서		연 구 소		A4	도번 CN01255-7/1 K314-518-004
	적도 1.5/1	단위 mm				